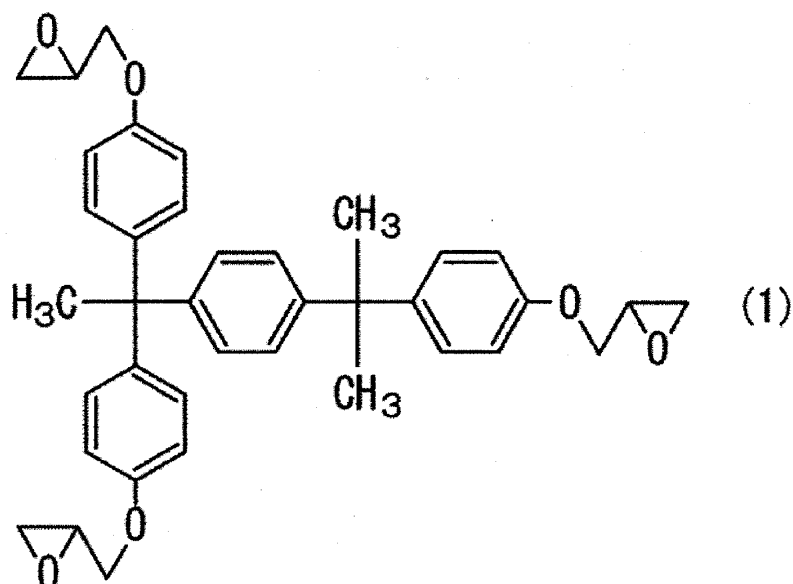


請求の範囲

〔請求項1〕 基材と、該基材の一方の面に設けられた熱硬化型の接着剤層とを備え、半導体装置のリードフレーム又は配線基板に剥離可能に貼着される半導体装置製造用接着シートにおいて、前記接着剤層は、カルボキシル基含有アクリロニトリル-ブタジエン共重合体（a）と、下記構造式（1）を有するエポキシ樹脂（b）と、マレイミド基を2個以上含有する化合物（c）とを含有し、未反応のマレイミド残留量が0.02～0.13であることを特徴とする半導体装置製造用接着シート。

〔化1〕



〔請求項2〕 前記（a）成分は、アクリロニトリル含有量が5～50質量%で、かつ、数平均分子量から算出されるカルボキシル基当量が100～20000のカルボキシル基含有アクリロニトリル-ブタジエン共重合体であることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置製造用接着シート。

〔請求項3〕 前記（a）成分100質量部に対し、前記（b）成分と前記（c）

成分との合計が20～300質量部であることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置製造用接着シート。

- [請求項4] 請求項1に記載の半導体装置製造用接着シートを用いた半導体装置の製造方法であって、
- リードフレーム又は配線基板に半導体装置製造用接着シートを貼着する貼着工程と、
 - 前記リードフレーム又は配線基板に半導体素子を搭載するダイアタッチ工程と、
 - 前記半導体素子と外部接続端子とを導通させるワイヤボンディング工程と、
 - 前記半導体素子を封止樹脂で封止する封止工程と、
 - 前記封止工程の後、半導体装置製造用接着シートをリードフレーム又は配線基板から剥離する剥離工程と、を備えることを特徴とする半導体装置の製造方法。